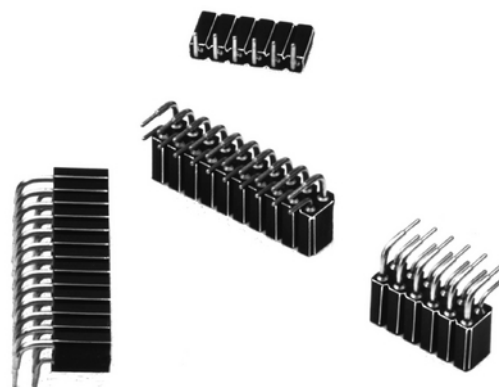


# Präzisions-Buchsenleisten RM 2,54mm, gewinkelt, 1-/2-reihig Precision Female Headers, 2.54mm Pitch, Right-Angled, Single/Double Row

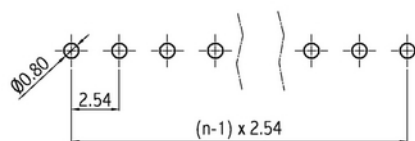
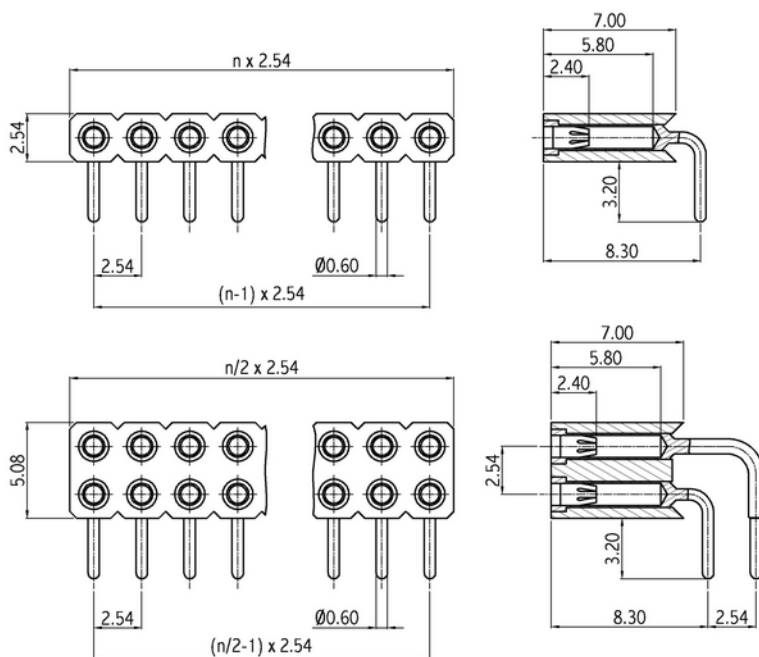
## Technische Daten / Technical Data

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Isolierkörper         | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0                           |
| Insulator             | Thermoplastic, rated UL94 V-0                                         |
| Kontaktmaterial       | Hülse: Messing gedreht<br>Feder: 6-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer    |
| Contact Material      | Sleeve: screw machined brass<br>Clip: 6-Finger-Clip, Beryllium-Copper |
| Kontaktoberfläche     | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)                      |
| Contact Surface       | Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)                  |
| Lötbarkeit            | IEC 60512-12A                                                         |
| Solderability         | IEC 60512-12A                                                         |
| Durchgangswiderstand  | < 10mΩ                                                                |
| Contact Resistance    | < 10mΩ                                                                |
| Isolationswiderstand  | > 1000MΩ                                                              |
| Insulation Resistance | > 1000MΩ                                                              |
| Spannungsfestigkeit   | 1kV <sub>RMS</sub>                                                    |
| Test Voltage          | 1kV <sub>RMS</sub>                                                    |
| Nennspannung          | 100V <sub>RMS</sub> / 150V <sub>DC</sub>                              |
| Voltage Rating        | 100V <sub>RMS</sub> / 150V <sub>DC</sub>                              |
| Nennstrom             | 3A                                                                    |
| Current Rating        | 3A                                                                    |
| Temperaturbereich     | -55°C ... +125°C                                                      |
| Temperature Range     | -55°C ... +125°C                                                      |
| Verarbeitung          | Wellen- oder Reflow-Lötverfahren                                      |
| Processing            | Wave or reflow soldering                                              |

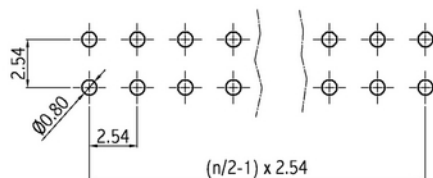


© W+P PRODUCTS

Einsetzbar für Rundstifte Ø 0,65 - 0,85mm  
oder Vierkantstifte 0,635mm. Auf Anfrage für  
Rundstifte Ø 0,4 - 0,56mm erhältlich.  
Accept round pins Ø 0.65 - 0.85mm or square  
pins 0.635mm. Also available for round pins Ø  
0.4 - 0.56mm on request.



PCB Layouts



## Series

154

## Contacts\*

002

002-050 Einreihig  
Single row  
004-100 Zweireihig  
Double row

## Rows\*

1

1 Einreihig  
Single row  
2 Zweireihig  
Double row

## Sleeve Plating

50

50 Hülse verzinkt  
Tin plated sleeve

## Clip Plating\*

00

00 Feder vergoldet  
Gold plated clip  
10 Feder 0,25µm Gold  
0.25µm gold plated clip  
30 Feder 0,75µm Gold  
0.75µm gold plated clip  
50 Feder verzinkt  
Tin plated clip

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
FAX +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL sales@wppro.com  
WEBSITE www.wppro.com

## Informationen zum Wellen-Lötverfahren

### Wave Soldering Information

## Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

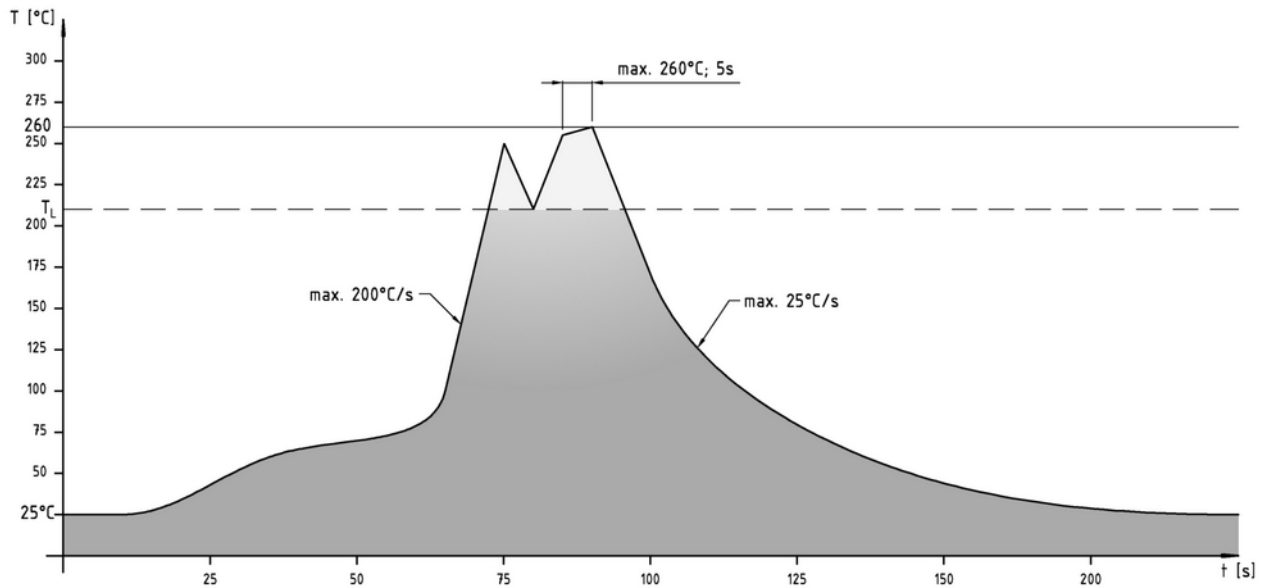
### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

Recommended wave soldering profile:



## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft                    | Kennwert     |
|--------------------------------------|--------------|
| Temperatur Minimum $T_{Smin}$        | 150°C        |
| Temperatur Maximum $T_{Smax}$        | 200°C        |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$          | 60-180s      |
| Temperatur Lötbereich $T_L$          | 217°C        |
| Verweildauer oberhalb $T_L$          | 60-180s      |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3°C / s |
| Höchsttemperatur $T_P$               | 260°C ±5     |
| Dauer Höchsttemperatur               | 20-40s       |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s      |
| Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$  | Max. 8 min   |

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature                      | Key Values   |
|--------------------------------------|--------------|
| Minimum Temperature $T_{Smin}$       | 150°C        |
| Maximum Temperatur $T_{Smax}$        | 200°C        |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$       | 60-180s      |
| Soldering Range Temperature $T_L$    | 217°C        |
| Duration above $T_L$                 | 60-180s      |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3°C / s |
| Peak Temperature $T_P$               | 260°C ±5     |
| Duration Peak Temperature            | 20-40s       |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s      |
| Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$     | Max. 8min    |

